**Zaproszenie do składania założeń polskich projektów IPCEI**

(Important Projects of Common European Interest)wpisujących się w łańcuch wartości w dziedzinie mikroelektroniki



Warszawa, 17 grudnia 2020 r.

# Wstęp

„Strategic Forum for IPCEI”[[1]](#footnote-1) sformułowało wizję przemysłu europejskiego w 2030
i działań mających na celu wzmocnienie konkurencyjności UE na rynku światowym, osiągnięcie stopniowej neutralności klimatycznej, zwiększenie autonomii
i bezpieczeństwa UE (łącznie z ochroną dostępu do danych i przetwarzania danych) oraz osiągniecie wiodącej pozycji UE w światowym przemyśle. Forum wskazało **mikroelektronikę** jako jeden z obszarów priorytetowych, o największym potencjale rozwojowym, wynikającym z obecnych uwarunkowań technologicznych i dotychczas podjętych decyzji w zakresie lokowania bazy przemysłowej.

Aby zapewnić Europie suwerenność technologiczną i konkurencyjność, jak również zdolność do sprostania kluczowym wyzwaniom środowiskowym i społecznym oraz nowym obszarom zastosowań, niezbędne jest wzmocnienie zdolności w Europie do opracowania i produkcji nowej **generacji procesorów i półprzewodników.** Będzie to wymagało połączenia wielu inwestycji i koordynacji działań podmiotów publicznych
i prywatnych.

**Niniejsze zaproszenie do składania założeń projektów / koncepcji, ma na celu zidentyfikowanie przedsiębiorstw zainteresowanych tym obszarem technologicznym w zakresie fazy badań i rozwoju (R&D&I) oraz pierwszego przemysłowego wdrożenia** **(FID)** w całym tworzącym się łańcuchu wartości,
(przykładowo rozpoczynającym się w fazie cyfrowego projektowania, poprzez materiały i komponenty, ich pakowanie i integrację, a skończywszy na fazie programowania). Realizacja projektów będzie możliwa w oparciu o udzieloną pomoc publiczną w ramach mechanizmu Important Projects of Common European Interest (IPCEI)[[2]](#footnote-2), opisanego w Komunikacie *Kryteria analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania* (Dz.Urz. UE. 2014/C 188/02) (zwanego dalej Komunikatem).

Oceniając poziom zainteresowania firm realizacją projektów w zakresie mikroelektroniki oraz po analizie możliwości finansowania projektów, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii rozważy ogłoszenie konkursu na projekty w ramach programu **IPCEI Mikroelektronika**, zaprojektowanego zgodnie z przyszłymi wytycznymi Komisji Europejskiej.

Projekty złożone w ramach IPCEI powinny charakteryzować się wysokim poziomem innowacyjności, pozytywnym wpływem na środowisko, jednocześnie przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności całego europejskiego przemysłu. Przewidywana do zastosowania technologia powinna wpisywać się w założenia nowej strategii przemysłowej Unii Europejskiej, a także w Europejski Zielony Ład oraz dawać podstawy do przemysłowego wdrożenia. Projekt powinien umożliwić osiągnięcie długotrwałej rentowności w przewidywalnej perspektywie czasowej. Korzyści płynące z projektu nie powinny ograniczać się tylko do danego przedsiębiorstwa lub sektora, powinny również tworzyć podstawy dla budowy nowego łańcucha wartości w UE
i oddziaływać na rozwój w innych jego ogniwach.

Projekt będzie miał szansę uzyskać wsparcie finansowe z zastrzeżeniem,
że przedmiot projektu spełni kryteria określone w pkt. 3 Komunikatu.

Kosztami kwalifikowalnymi będą koszty wymienione w załączniku do Komunikatu,
w granicach wyliczonej luki finansowej realizacji projektu.

Zapraszamy do przygotowania opisu założeń projektu[[3]](#footnote-3) wg załączonego wzoru (maksymalnie do 20 stron) i przekazania go w formacie PDF (z możliwością przeszukiwania) drogą elektroniczną w terminie do **24 stycznia 2021 r.** na adres
e-mail: ipcei-elektronika@mrpit.gov.pl

#

#

#

# WZÓR DOKUMENTACJIOpis założeń projektu wpisującego się w łańcuch wartości w dziedzinie MIKROELEKTRONIKI

Spis treści

[Wstęp 2](#_Toc59175596)

[WZÓR DOKUMENTACJI Opis założeń projektu wpisującego się w łańcuch wartości w dziedzinie MIKROELEKTRONIKI 4](#_Toc59175597)

[1. Lider konsorcjum 6](#_Toc59175598)

[2. Obszar w jaki wpisuje się projekt 6](#_Toc59175599)

[3. Podsumowanie projektu 6](#_Toc59175600)

[4. Cele ogólne i szczegółowe 7](#_Toc59175601)

[5. Konsorcjum 7](#_Toc59175602)

[6. Rynek i stan technologii 7](#_Toc59175603)

[7. Harmonogram realizacji projektu 7](#_Toc59175604)

[8. Budżet projektu 8](#_Toc59175605)

[9. Finansowanie 8](#_Toc59175606)

[10. Uzasadnienie konieczności i stosowności pomocy państwa w ramach mechanizmu IPCEI 8](#_Toc59175607)

[11. Oszacowanie OCZEKIWANEJ wysokości wsparcia finansowego ze strony państwa 8](#_Toc59175608)

[12. Ocena efektywności ekonomicznej projektu 9](#_Toc59175609)

[13. Ryzyka 9](#_Toc59175610)

[14. Potencjalna lokalizacja 9](#_Toc59175611)

[15. Wpływ projektu na sektor Mikroelektroniki w Polsce i Europie 9](#_Toc59175612)

[16. Powiązanie projektu z europejskimi inicjatywami 10](#_Toc59175613)

# Lider konsorcjum

|  |
| --- |
| Dane jednostki zgłaszającej / konsorcjum  |
| * *Dane kontaktowe*
* *Osoba do kontaktu*
* *Opis działalności firmy*
 |

# Obszar w jaki wpisuje się projekt

|  |
| --- |
| Obszar projektu (proszę wybrać obszar z listy lub wskazać własny) |
| 1. Projektowanie procesorów i układów scalonych dla sztucznej inteligencji (Design of processors and chips for AI),
2. Projektowanie chipów do komunikacji (5G, 6G i inne) oraz łączności (Design of chips for communication (5G, 6G and other) and connectivity),
3. Rozwój i produkcja tych chipów w Europie (Development and manufacturing of these chips in Europe)
4. Techniki mikromontażu dla heterogenicznej integracji (Advanced packaging for heterogenous integration)
5. Podłoża półprzewodnikowe dla radiotechniki i elektroniki mocy (Semiconductor substrates for RF and Power electronics)
 |

# Podsumowanie projektu

|  |
| --- |
| Podsumowanie projektu  |
| * *Podsumowanie projektu - tytuł, cele, efekty ekonomiczne i technologiczne projektu, przewagi konkurencyjne*
 |

# Cele ogólne i szczegółowe

|  |
| --- |
| Cele projektu |
| * *Cele ogólne*
* *Cele szczegółowe*
* *Wskaźniki realizacji celów*
 |

# Konsorcjum

|  |
| --- |
| Zakładany skład konsorcjum  |
| * *Firmy i partnerzy uczestniczący w projekcie i ich role*
* *Wyszczególnienie partnerów z UE*
* *Charakterystyka poszczególnych podmiotów*
 |

# Rynek i stan technologii

|  |
| --- |
| *Rynek i stan technologii*  |
| * *Aktualny stan technologii b*ędącej przedmiotem projektu
* *Aktualny stan rynku w ww. zakresie*
* *Potencjał rynkowy*
* *Otoczenie rynkowe*
* *Konkurencja*
 |

# Harmonogram realizacji projektu

|  |
| --- |
| Harmonogram  |
| * *Czas trwania projektu*
* *Etapy realizacji*
* *Kamienie milowe*
 |

# Budżet projektu

|  |
| --- |
| Budżet projektu wraz z planem kosztów i wydatków |
| * *Szacunkowy koszt projektu*
* *Kategorie i wysokość kosztów*
 |

#  Finansowanie

|  |
| --- |
| Plan finansowania inwestycji |
| * *Fundusze własne*
* *Fundusze zewnętrzne*
 |

# Uzasadnienie konieczności i stosowności pomocy państwa w ramach mechanizmu IPCEI

|  |
| --- |
| Wykazanie konieczności pomocy państwa w ramach mechanizmu IPCEI |
| * *Uzasadnienie konieczności finansowania projektu w ramach mechanizmu IPCEI*
 |

# Oszacowanie OCZEKIWANEJ wysokości wsparcia finansowego ze strony państwa

|  |
| --- |
| Wysokość wsparcia finansowego ze strony państwa |
| * *Oszacowanie luki finansowej realizacji projektu i wysokości wsparcia finansowego państwa*
 |

# Ocena efektywności ekonomicznej projektu

|  |
| --- |
| Ocena efektywności ekonomicznej projektu |
| * *Analiza i ocena efektywności ekonomicznej projektu w zakładanym horyzoncie czasowym*
 |

# Ryzyka

|  |
| --- |
| Kluczowe ryzyka związane z realizacją projektu  |
|  |

# Potencjalna lokalizacja

|  |
| --- |
| Potencjalna lokalizacja planowanej inwestycji |
| * *Potencjalna lokalizacja/-e inwestycji (badania i rozwój, produkcja)*
* *Uzasadnienie wyboru lokalizacji*
 |

# Wpływ projektu na sektor Mikroelektroniki w Polsce i Europie

|  |
| --- |
| Ocena wpływu projektu na sektor mikroelektroniki w Polsce i Europie |
| * *Ocena wpływu na rynek mikroelektroniki (skutki pozytywne i negatywne)*
 |

# Powiązanie projektu z europejskimi inicjatywami

|  |
| --- |
| Powiązanie projektu z europejskimi inicjatywami z obszaru mikroelektroniki  |
|  |

1. 30 stycznia 2018 Komisja Europejska powołała „Strategic Forum for IPCEI” zarządzane przez DG GROW składające się z 45 członków reprezentujących państwa członkowskie UE, przemysł i społeczność naukową. [↑](#footnote-ref-1)
2. Komunikat Komisji Europejskiej dot. IPCEI - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0620(01)&from=EN> [↑](#footnote-ref-2)
3. Treść przesłanych założeń projektów uznana zostanie za tajemnicę przedsiębiorstwa
tylko wówczas, gdy zgłaszający dokona wyraźnego zastrzeżenia na piśmie. Tożsamość podmiotów zgłaszających założenia projektów pozostanie informacją publiczną.  [↑](#footnote-ref-3)